



PRESSEMITTEILUNG

Veröffentlichung vom Juni 2023, Business Unit: Wireless

Wireless Design-In

Module für anspruchsvolle IoT-Anwendungen

Mit vier neuen Modulen erweitert HY-LINE Communication Products ihr Produktportfolio in den Technologien Cellular 5G, Wi-Fi und Bluetooth. Darüber hinaus steht ein kostenloses Whitepaper über eUICC zur Verfügung, das die Vorteile dieser Technologie für das IoT im Vergleich zur herkömmlichen SIM-Karte erklärt.

Das neue 5G NR Sub-6 GHz Modul EM9291 bietet globale Netzabdeckung, Dual SIM mit schnellem Umschalten und ist für Private Networks CBRS zertifiziert. Mit dem Modul lassen sich eine Vielzahl von IoT-Anwendungen wie Industrierouter, Home-Gateways, Industrie- und Verbraucher-Laptops, robuste Tablet-PCs, Videoüberwachung und Digital Signage realisieren.

Für reichweitenstarke und energiesparende Bluetooth-Anwendungen ist das PAN1770 Bluetooth Low Energy Module mit UF.L Connector geeignet. Es bietet Bluetooth 5.1 LE einschließlich LE 2M und LE Coded PHY. Seine weiteren Features sind der RF52840 Controller auf Basis des ARM Cortex-M4F Prozessors, integrierter 1 MB Flash-Speicher und 256 kB interner RAM. Der extrem niedrige Stromverbrauch macht das PAN1770 Modul zur idealen Wahl für batteriebetriebene Geräte.

Eine zuverlässig sichere Plug-and-Play-Wireless-Konnektivität für die NXP i.MX-Serie und andere Plattformen ermöglicht das Dual-Band Wi-Fi 6 plus Bluetooth Combo SDIO Modul SX-SDMAX. Es unterstützt mit Wi-Fi 6 den neuesten 802.11ax Standard.

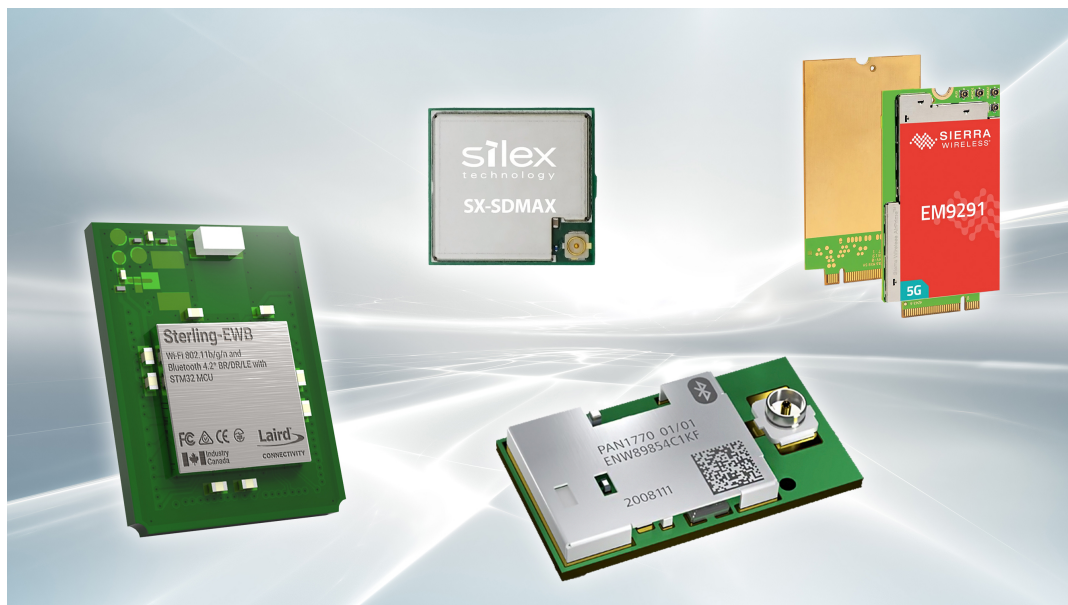
Abgerundet wird das neue Angebot an Modulen durch den Sterling-EWB, das Hostless WiFi 4 mit Bluetooth 5.1 und ARM Cortex M4 auf einem kompakten Board vereint. Der AT-Command Set ermöglicht einen vereinfachten, benutzerfreundlichen Ansatz für die Anwendungsentwicklung.

Über die Vorteile der eUICC-Technologie, die eine Alternative zur herkömmlichen SIM-Karte ist, informiert das kostenlose Whitepaper „eUICC - Ein Wendepunkt für das IoT“. eUICC steht für „embedded Universal Integrated Circuit Card“ und ist eine Technologie, die sich besser für die sich schnell entwickelnden Anwendungsfälle des Internets der Dinge (IoT) eignet. Interessenten können das Whitepaper auf der HY-LINE Website herunterladen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.hy-line-group.com/wireless-design-in

Pressebild



A10789-01_Wireless_Design-In.jpg

HY-LINE Communication Products

Tel. 089 / 614503-60

Email: communication@hy-line.de